



印刷でエレクトロニクス産業の未来を開く

MINAMI CO.,LTD.



会社概要

代表取締役社長：村上 武彦

設立：1980年11月

営業内容：スクリーン印刷機(表面実装機及び半導体関連)
真空リフロー炉、ボールプレーサ、アンダーフィル剤脱泡機
真空遠心脱泡機・LED樹脂充填用印刷機の開発・製造・販売

本社工場：東京都府中市

資本金：2億6,500万円

売上高：40億円(平成22年3月期計画)

従業員：143人

国内営業所：東京、大阪、仙台、熊本

国内実装工場：「EMSつくば工場」茨城県阿見町

国内関連会社：村上建設株式会社

海外実装工場：MMET Inc. (フィリピン)

海外グループ会社：MINAMI TWIN ADAVANCE SDN BHD (マレーシア ペナン)

MME Inc. (フィリピン)、EMST PVT, LTD. (インド)

南実装機械(上海)有限公司(中国 上海)



沿革

1980年: 表面実装技術関連製品、設備の販売会社として設立

1984年: 全自動スクリーン印刷機の製造・販売開始

1991年: 全自動視覚認識装置付きスクリーン印刷機の製造・販売開始

2000年: 「ロータリースキージ」、「加圧印刷システム」の販売開始

2004年: 「スクリーン印刷技術によるウェハレベルCSPのパッケージング」
で中小企業庁長官賞を受賞
真空リフロー炉の製造・販売開始

2005年: 東京商工会議所の主催する高度モノづくり企業「第3回勇気ある経営大賞」
優秀賞授賞と経済大臣賞を授賞

第三者割当増資にて資本金2億6500万円へ

2006年: 茨城県阿見町に実装及び半導体受託工場を開設



ミナミのスクリーン印刷機の市場での位置付け

1. SMT向けスクリーン印刷機

- ・累計販売台数 約4,000台 うちロータリースキージ付 約800台
- ・国内シェア 25~30% 世界シェア 5~10%
- ・競合他社 松下電器産業、日立ハイテク、ヤマハ発動機、DEK、MPM
- ・主力製品 MK-MK、MK878SV、MK888SV
- ・主要顧客 ミツミ電機、アイシン精機、アイシンAW、FOXCONN、フジクラ他

2. 半導体向けスクリーン印刷機

- ・累計販売台数 200台 うちロータリースキージ・加圧付 約100台
- ・国内、海外ともに100%近い
- ・競合他社 なし
- ・主力製品 MK838SV MK1208SV MKR1200、MK3000
- ・優位性 スクリーン印刷技術による半導体パッケージングプロセスを開発し、低コストと高い信頼性を提供できること
- ・主要ユーザー NEC、ソニー、台湾PPT、ルネサス、ローム、三洋半導体
京セラ、Samsung, TI, NXP semiconductor, CASIO他



- 本社

- 東京都府中市南町5-38-32

TEL 042-354-1881

FAX 042-354-1883

- EMSつくば工場

- 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見5445-9

TEL 029-891-2331

FAX 029-887-0711

ISO 9001:2000認定工場



ミナミ株式会社 EMSつくば工場

ISO9001認定書



努力を惜しまない品質改善
品質維持でお客様の笑顔

2009年度

半導体生産部 ラインナップ

印刷機:MK-1208



印刷機:MK-838



真空リフロー炉(プラズマ付き):MKR-1200



ホールプレーサ:MK-3000



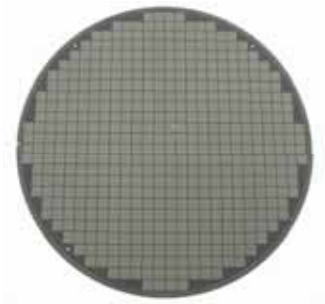
ホールプレーサ:MK-2000



洗浄機:WT-1



Bump プロセス工程フロー...1



印刷機:MK-1208



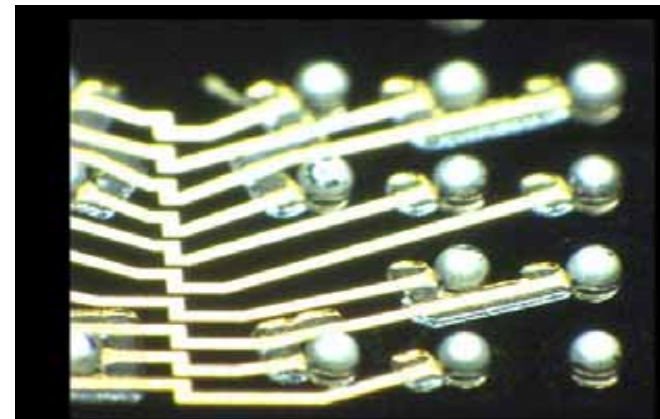
印刷後のイメージ



真空リフロー炉(プラズマ付き):MKR-1200



リフロー炉後のイメージ

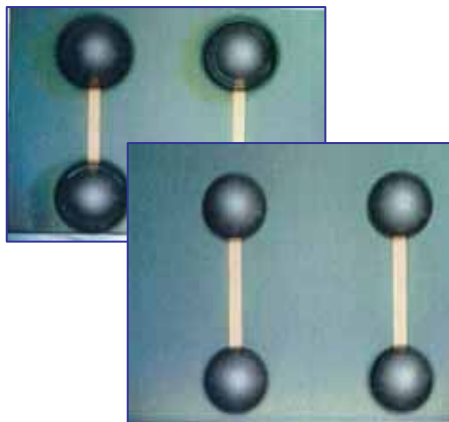


Bump プロセス工程フロー... 2

洗浄機: WT-1



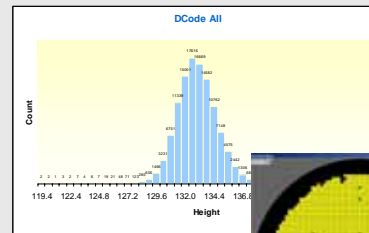
フラックス洗浄後



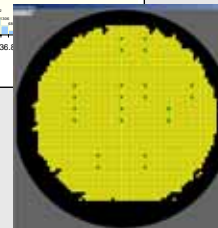
ハンブ高さ検査: 3D-1



高さ: ヒストグラム



マップデータ



ボンドテスタ-PC-2400



ホールシェア試験



ハンダ Bump & ホール Bump プロセス

印刷機:パッド充填



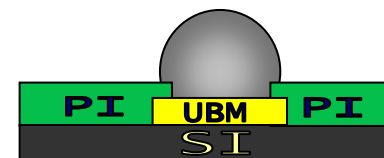
真空リフロー炉:ハンダ接合



洗浄機:フラックス除去



ハンダ



印刷機:フラックス充填



ホールプレス:ホール搭載



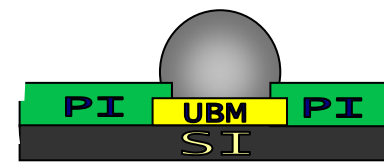
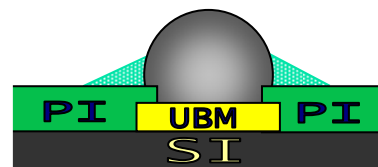
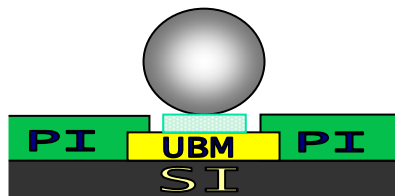
真空リフロー炉:ホール接合



洗浄機:フラックス除去



ホール

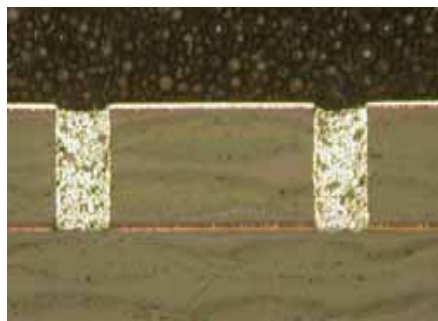


その他、印刷事例

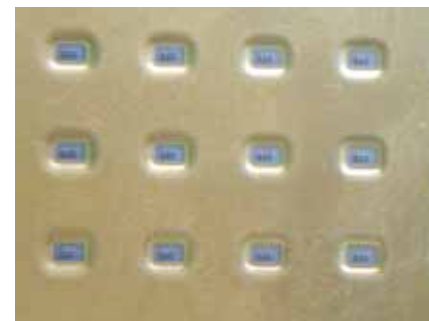
ウエハ：バックコート印刷



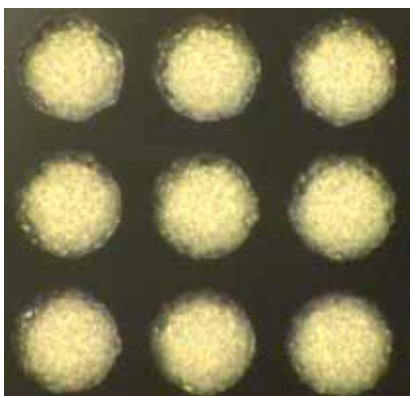
グリーンシート：有底VIA印刷



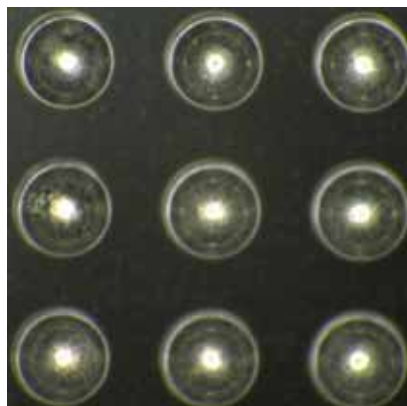
CMOS：キャビティ基板印刷



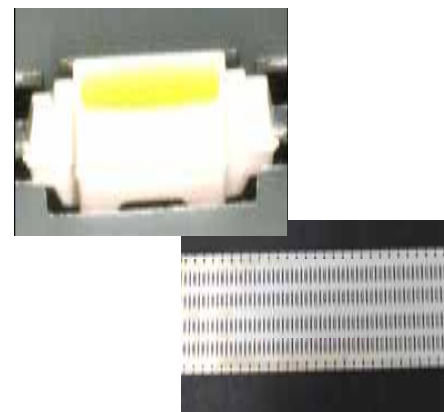
メッキBumpポスタ Sn-Ag3.5

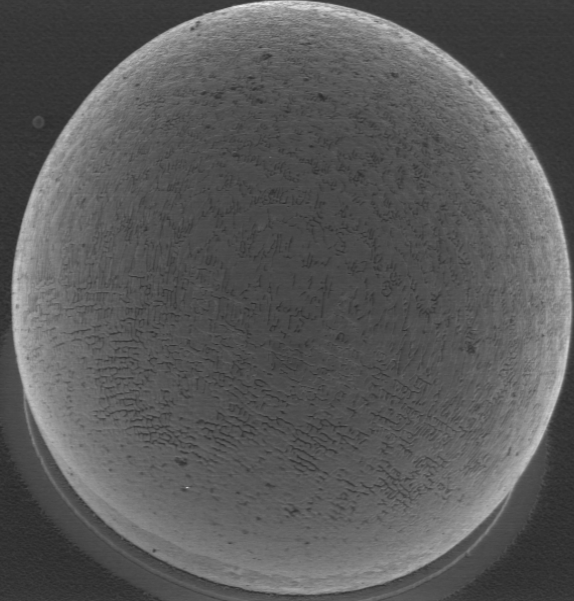


プラズマ照射還元後



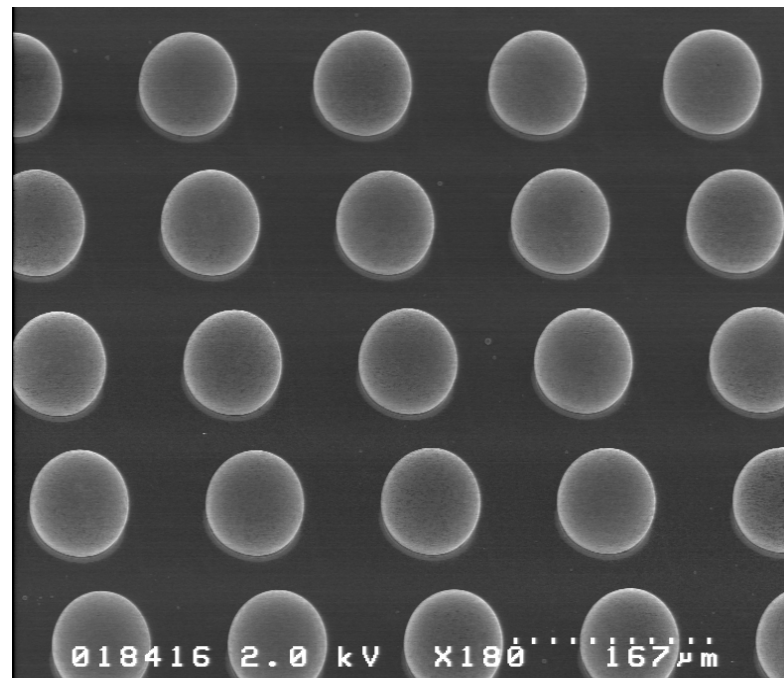
リードフレーム：LED混合樹脂印刷





018415 2.0 kV X1.00K 30.0µm

Thank you!



018416 2.0 kV X180 167µm